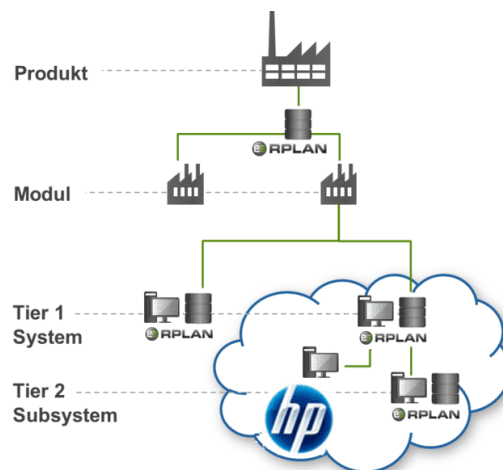


Presseinformation

ACTANO bringt die Kollaborative Projektmanagementsoftware RPLAN e3 in die Cloud - Bevorzugter Infrastrukturpartner für die Marktumsetzung ist Hewlett-Packard

Die neue Cloudlösung zielt vor allem darauf, Herstellern und Zulieferern einen zügigen Start in internationale und unternehmensübergreifende Entwicklungspartnerschaften zu ermöglichen.

München, 01. Dezember 2011 – Technologie-Merger zwischen den Herstellern, die zunehmende Einbeziehung von Zulieferern in Entwicklungsprojekte und steigende Produktivitätsvorgaben erfordern die zügige Einrichtung einer stabilen und homogenen Entwicklungsumgebung. Als einer der ersten Anbieter trägt ACTANO den gewachsenen Anforderungen an die Planung und Steuerung komplexer Produktentstehungsprozesse umfassend Rechnung und startet mit RPLAN e3 in der hoch verfügbaren Cloud. Auf diesem Gebiet arbeitet ACTANO bevorzugt mit Hewlett-Packard als Infrastrukturpartner für die Marktumsetzung zusammen. Das gemeinsame Ziel sind kundenspezifische Cloudlösungen, die eine kollaborative Projektintegration weltweit verteilter Hersteller und Zulieferer deutlich vereinfachen.



Die Einbindung der Entwicklungspartner über RPLAN e3 als Cloudlösung ermöglicht ein durchgängiges Projektmanagement im gesamten Wertschöpfungsnetzwerk.

Michael Laurim, Geschäftsführer bei ACTANO, erläutert: „Im Zeichen neuer Technologien wird die Zahl der Joint-Ventures und Partnerschaften nicht nur im Automotive-Segment weiter wachsen. Mit Hewlett-Packard steht uns ein idealer Innovations- und Infrastrukturpartner zur Seite, um internationale Projektmanagement-Umgebungen mit erheblich reduzierten Eintrittshürden aufzusetzen. Die kollaborative RPLAN e3-Methodik, durchgängiges Cross Company Project Management und Cloud-basierte Wertschöpfungsnetzwerke sind eine überzeugende Basis – sowohl für Partnerschaften zwischen den Herstellern als auch für eine effektive Einbindung von Zulieferern.“

„Die Partnerschaft mit ACTANO“, bestätigt Oliver Bahns, Director Automotive und Aerospace bei Hewlett-Packard, „führt zu einer Projektmanagementlösung in der Cloud, die die Anforderungen an eine verteilte Produktentwicklung und die damit verbundene Integration externer Partner entlang der Wertschöpfungskette umfassend erfüllt. Gemeinsam mit ACTANO sind wir in der Lage, eine Cloudlösung für das Projektmanagement und das Ecosystem eines OEMs zu realisieren. Dabei haben alle Beteiligten einen sicheren Zugriff auf die RPLAN e3-Software.“

ACTANO GmbH

Mit der Software RPLAN und umfassender Implementierungsberatung planen und steuern Unternehmen aus der diskreten Fertigungsindustrie die Entwicklung komplexer Produkte. RPLAN e3 integriert nationale und internationale Zulieferer in durchgängigen Wertschöpfungsketten und sorgt so für hoch produktive Produktentstehungsprozesse. Über 100 namhafte Unternehmen und mehr als 120.000 Anwender weltweit meistern gegenwärtig mit RPLAN und RPLAN e3 Herausforderungen wie Globalisierung und Heterogenität, die Einbindung nicht industrialisierter Partner sowie die Synchronisation und Interaktion in dynamischen Prozessen. Zu den Kunden gehören Airbus, Allgaier Werke, Audi, BMW, Daimler, MTU Aero Engines, VW u.v.m. ACTANO pflegt Partnerschaften mit führenden Lösungsanbietern, Engineering Dienstleistern sowie IT Infrastrukturanbietern, darunter Siemens PLM, PTC, MHP und Hewlett-Packard. Das in München ansässige Unternehmen unterhält Niederlassungen in Stuttgart, Wolfsburg sowie Detroit/USA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ACTANO.de

ACTANO GmbH

Ute Brodowsky
Ute.Brodowsky@ACTANO.de
089/206044-0
Paul-Heyse-Str. 26-28
80336 München
<http://www.ACTANO.de>

INTERFACE FACTORS GmbH

Dr. Ralph Klöwer
r.kloewer@interface-factors.de
089/55 26 88 66
Landshuter Allee 12
80637 München